LAGENAUFBAU HDI (Standard)

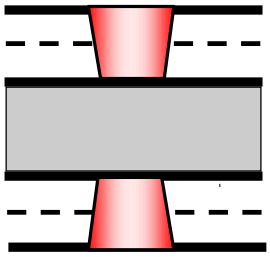
HDI04_1+2+1_0,90_35

4 - Lagen

Kern: 0,71 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 2 + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	2			35 µm		**33**	
			0,710 mm			**710**	
3	3			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
4	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material:				920	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**0,90**	+/-	0,08	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	0,98	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,04	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
04.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.01.2006	R. Schönholz	00	3+